

苏州国芯科技股份有限公司

2023年9月5日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	广发基金；申万菱信基金；银河基金；富安达基金；开源证券；华泰证券；上海磐安资管；国盛资管；浙江瑞丰达资管；台州明道投资；上海银叶投资
时间	2023年9月5日 13:30；2023年9月5日 14:30；2023年9月5日 15:30
地点	上海浦东香格里拉酒店现场交流
上市公司参加人员姓名	证券事务代表：龚小刚先生；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司的研发情况？</p> <p>答：2023年上半年，公司为大力发展汽车电子芯片和高可靠存储控制芯片，围绕汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片等领域，较大幅度增加了研发人员数量，增加了芯片研发材料投入，导致本报告期研发费用比上年同期增加 5,282.61 万元左右，增长幅度 92.29%，其中人员费用 6,609.65 万元，比上年同期增加 3,221.99 万，增长幅度 95.11%；公司研发人数 294 人，同比增长 72.94%，研发人员占公司总人数的 67%；研发投入占营业收入比重 49.88%，同比增加 22.52 个百分点。</p> <p>2、公司在汽车电子领域的发展情况是怎样的？</p> <p>答：在汽车电子领域，公司正在重点发展系列化汽车电子芯片，在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用 SoC 芯片、线控底盘芯片、仪表芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等 12 条产品线上实现系列化布局，为解决我国汽车行业“缺芯”问题作出努力。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司汽车电子和工业控制业务的在手订单金额为 0.73 亿</p>

元，公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、长城、一汽、东风、小鹏等众多汽车整机厂商，在 20 余款自主及合资品牌汽车上实现批量应用。截至 2023 年 6 月 30 日，已量产的汽车电子项目数（个）达到 13 个，新开发的汽车电子项目数（个）达到 56 个。接下来，公司将继续集中力量做好新项目的开发工作，着力攻坚头部重点客户、重点项目，尽可能实现项目的快速量产。

3、请问公司对外投资情况是怎样的？

答：在主营业务范围内，公司继续推进与半导体产业生态圈的伙伴展开多样化合作，并在重点业务领域以投资入股的方式与部分技术创新能力强、市场竞争力强、协同潜能大的企业加强协同发展，先后投资参股了提供高速互联接口 IP 产品的上海奎芯、提供第七代 IGBT 芯片产品的上海睿驱、全国产高性能大算力 AI 芯片公司江原创芯和先进存储芯片技术公司凌存科技等一系列实力新创企业。奎芯集电作为国内重要的高速互联 IP 产品提供商，在高速接口 IP、chiplet 产品及方案方面与公司具有广阔的协同空间。上海睿驱以其先进的 IGBT 芯片产品与公司 MCU 芯片产品可形成极具优势的联合推广方案。江原创芯的高性能大算力 AI 芯片技术有望与公司展开深入合作。凌存科技 MRAM 技术将为公司未来车用存储芯片和存算一体化芯片的发展提供支撑。国芯科技的产业投资有助于充分发挥多方的优势资源，从加快技术创新、推动产品落地、拓宽商业边界和部署技术前沿等多维度服务于公司发展战略，有助于进一步增强公司竞争力，从而更好地回馈广大投资者。

4、请介绍下公司汽车电子 MCU 新产品 CCFC3008PT？

答：公司成功研发的汽车电子 MCU 新产品 CCFC3008PT 是基于公司自主 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核研发的新一代适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核 MCU 芯片，是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。

该芯片基于 40nm eFlash 工艺开发和生产，内嵌 3 个运行频率达到 300MHz 的运算 CPU 核，其中包括两个主核和一个锁步核，另外还内嵌一个运行 200MHz 的控制 CPU 核；该芯片内嵌一个硬件安全 HSM 模块，支持 AES/Crypto/SM2 等国际和国密算法，可以支持安全启动和 OTA；该芯片内嵌多种独立的汽车标准通讯接口，主要包括：支持 TSN 协议 10M/100M 以太网接口（1 路）、FlexRay（1 路）、eSCI（6 路，支持 LIN 和 UART）、MCAN（8 路）以及对外控制接口 eMIOS（64 通道）、高效时序处理单元 eTPU（64 通道）、通用时序处理单元 GTM 和串行通讯接口 DSPI（4 路，支持 MSC），该芯片还配置了较大容量的存储

	<p>空间，其中程序存储Flash最高配置可达4M字节，数据存储最高配置Flash最高可达512K字节，内存空间（SRAM）最高配置可达640K字节，具有ADC（数模转换）控制电路。</p> <p>本次成功研发的汽车电子MCU新产品CCFC3008PT按照汽车电子Grade1等级、信息安全Evita-Full等级、功能安全ASIL-D等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了该产品的应用覆盖面；该产品的封装形式包括BGA416/BGA292/LQFP216等，可以广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器。目前，该芯片已经在多家客户开展应用模组的开发和测试。</p> <p>5、公司在高性能计算和AI领域的布局情况如何？</p> <p>答：在高性能计算和 AI 领域，国芯科技已经开发了面向高性能运算的 64 位 CRV-7 CPU 内核，该处理器对标国外的 Cortex-A55，其性能超越 A55，且带有全国产化的生态和开发环境。基于 RISC-V 指令架构的神经网络扩展指令集架构研究，作为在 RISC-V 处理器上运行的扩展自定义指令，形成神经网络处理器专用指令集，能够支持神经网络算法的加速处理，并用于 CRV4AI 和 CRV7AI 处理器的实现中。公司已在生物特征识别领域推出了包括轻量级 AI（卷积协处理器）的 SoC 芯片，实现指纹和人脸识别应用，未来公司将在现有基础上继续发展生物特征识别领域的高性能 AI 芯片。在边缘计算领域，公司研发的芯片具备多核计算、网络路径和协议加速引擎、路由转发以及多种高速通信接口，适用于边缘计算领域产品的计算、安全及通信需求。高性能边缘计算、安全和网络通信集成处理控制芯片 CCP1080T，基于 14nm 工艺设计，采用国芯 64 位多核 PowerPC 架构 CPU 核，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎等，具有万兆网、PCIe3.0、USB3.0 等高速接口，目前该芯片产品已进入量产，开展市场推广。在高性能计算和 AI 领域芯片定制服务方面，公司目前已有多个高性能计算和 AI 芯片定制服务的在手订单。截至 2023 年 6 月 30 日，高性能（边缘）计算和人工智能业务的在手订单为 4.13 亿元。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 9 月